

## SPARC T3-2 서버

지금까지 경험하지 못한 확장성과 추가 비용 없이 제공되는 가상화 기술

### 주요 기능 및 이점

- 서버당 최고 256개의 동시 컴퓨팅 스레드
- 이전 세대의 SPARC T-series 시스템 보다 성능이 2배 향상
- Oracle VM Server for SPARC (이전의 Sun Logical Domains)에 추가 비용 없이 가상화 기술 내장
- 이전 세대 시스템 보다 I/O 성능이 4배 향상
- 최고 10개의 PCI Express Module 슬롯을 지원하는 등 뛰어난 I/O 성능
- 통합 온칩 암호 가속화 기술
- Oracle Sun Flash Accelerator F20 PCIe 카드를 통해 애플리케이션 응답 시간을 단축하고 에너지 소비 절약
- 어떠한 변경 없이 Oracle Solaris 10 OS에서 Oracle Solaris 9 OS 애플리케이션 실행

오늘날 기업들이 직면한 가장 큰 문제로는 공간 활용 부족, 에너지 및 냉각 비용 증가, 사용자가 밀집된 데이터센터 등이 있습니다. 규모에 관계 없이 모든 기업들이 데이터센터 통합에 있어 경제적 어려움을 느끼고 있습니다. Oracle SPARC T3-2는 레저시 서버를 통합함으로써 귀중한 데이터센터 공간을 절약하고 운영 비용을 대폭 절감할 수 있도록 해줍니다.



그림 1: SPARC T3-2 서버는 레저시 서버를 통합하기 위한 최적의 솔루션입니다.

### 제품 개요

가장 최신의 2소켓, 3RU 서버인 SPARC T3-2는 16코어 SPARC T3 프로세서를 장착한 업계 최초의 256스레드 범용 서버입니다. 단일 실리콘에 32개의 코어와 256개의 동시 스레드가 포함되어 있으며, 단일 칩에서 컴퓨팅, 네트워킹, 보안성, I/O 등 전체 시스템의 주요 기능들이 모두 제공됩니다.

SPARC T3-2는 6개의 하드 드라이브(HDD), 32개의 DDR3 DIMM 슬롯, 10개의 PCI-e Gen2 슬롯을 가지고 있습니다. 8GB DDR3 DIMM에서 완전 장착 시 총 256GB의 메모리를 제공합니다.

SPARC T3-2 서버는 추가 비용 없이 가상화 기술을 내장하고 있기 때문에 기업들은 IT 자산으로부터 최대 가치를 이끌어내는 동시에 동적으로 변화하는 오늘날의 비즈니스 환경에 발 빠르게 적응하는 인프라를 구축할 수 있습니다. Oracle VM Server for SPARC는 논리적(또는 가상) 도메인이라는 파티션을 생성함으로써 효율성이 뛰어난 엔터프라이즈급 가상화 기능을 제공합니다. 각각의 논리적 도메인은 독립된 운영 체제를 가질 수 있습니다. 32개의 논리적 도메인으로도 최적의 결과를 달성할 수 있지만, SPARC T3-2 서버는 128개의 논리적 도메인을 지원함으로써 IT 조직이 워크로드를 통합하고 컴퓨팅 플랫폼의 사용을 극대화할 수 있도록 돕는 것은 물론, IT 인프라를 단순화하며 데이터센터에 한 차원 향상된 효율성, 관리의 용이성 및 기민성을 제공합니다.

SPARC T3-2 서버 사양

<b>주요 적용 분야</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ERP/CRM 같은 비즈니스 애플리케이션</li> <li>• 과금, 공급망, 엔지니어링 및 제조를 위한 전문 애플리케이션</li> <li>• 가상화와 통합</li> <li>• 웹 서버</li> <li>• 보안 애플리케이션</li> </ul>	
<b>아키텍처</b>	
<b>프로세서</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16코어 1.6GHz SPARC T3 프로세서</li> <li>• 시스템당 2개의 프로세서(최고 256개의 스레드)</li> <li>• 16 FPU(Floating-Point Units)</li> <li>• 듀얼 멀티스레드 통합 온칩 10GbE PCI</li> <li>• 새로운 Kasumi Bulk 알고리즘을 이용한 온보드 암호화 기술. 12개 내장 암호 지원 업계 표준 암호: DES, 3DES, AES, RC4, SHA1, SHA256, SHA384, SHA512, MD5, RSA to 2048 key, ECC, CRC32</li> </ul>	
<b>프로세서당 캐시</b>	
6 MB 통합 L2	
<b>주 메모리</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 DDR3 DIMM 슬롯, 최대 256GB 시스템</li> <li>• 4GB 및 8GB DIMM 지원</li> </ul>	
<b>시스템 아키텍처</b>	
SPARC V9 아키텍처, ECC 보호	
<b>표준/통합 인터페이스</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>네트워크.</b> 4x 1Gb (10/100/1000Mbps) 통합 Ethernet 포트. 4x 10GbE XAUI 포트를 위한 옵션 슬롯.</li> <li>• <b>확장 버스.</b> 총 10개. 8개의 x8 PCIe Gen2 슬롯, 2개의 x4 PCIe Gen2 슬롯.</li> <li>• <b>포트.</b> 4개의 외장 USB 2.0 포트, 1개의 내장 USB 2.0 포트, 썸 드라이브(thumb drive)로 사용 제한</li> </ul>	
<b>대용량 스토리지 및 미디어</b>	
내장 디스크	최고 6개의 300GB GB 2.5인치 SAS 드라이브. 내장 DVD: 1개의 슬림형 SATA DVD+/-RW.
외장 스토리지	썸은 세계적으로 정평이 나 있는 서비스 및 지원과 함께 동급 최강의 혁신적인 스토리지 하드웨어 및 소프트웨어로 구성된 완벽한 제품 라인을 제공하고 있습니다. 보다 자세한 정보를 원하시면, <a href="http://oracle.com/storage">oracle.com/storage</a> 로 문의하여 주십시오.
<b>전원 공급장치</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2개의 핫 스왑형 AC 2,000W 리던던트(N+1) 전원 공급장치</li> <li>• 작동 시 최대 입력 전류: 12A @ 200 V AC</li> <li>• 200 V AC에서 작동 시 최대 출력: 2375W</li> </ul>	

주요 RAS 기능	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 핫 플러그형(Hot-pluggable) 디스크 드라이브</li> <li>• 리던던트 핫 스왑형 전원 공급장치 및 팬</li> <li>• 환경 모니터링</li> <li>• 오류 복구 및 패리티(parity) 검사 메모리</li> <li>• 간편한 구성 요소 교체</li> <li>• RAID 0 및 1을 지원하는 통합 디스크 컨트롤러</li> <li>• Electronic Prognostics 1.1</li> </ul>	
소프트웨어	
운영체제	Oracle Solaris 10 9/10
포함 소프트웨어	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oracle Solaris 10 9/10</li> <li>• Oracle VM Server for SPARC 2.0</li> <li>• Electronic Prognostics 1.1</li> </ul>
가상화	
Oracle VM Server for SPARC (이전의 Sun Logical Domains) 및 Oracle Solaris Containers는 단일 서버에서 128개 버추얼 시스템의 유연성과 위력을 제공합니다.	
환경	
작동 온도	• 5°C~35°C (41°F~95°F)
비작동 온도	• -40°C~65°C (-40°F~149°F)
작동 상대 습도	• 10%~90%, 비응결, 습구 온도 27°C
비작동 상대 습도	• 93%, 비응결, 습구 온도 38°C (100.4°F)
작동 고도	• 0미터~3,000미터(0피트~10,000피트)
비작동 고도	• 0미터~12,000미터(0피트~40,000피트)
노이즈 방출	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 61.2 dBA (LwAd: 1 B = 10 dB)</li> <li>• 61.5 dBA operating max (LpAm: bystander positions)</li> </ul>
냉각	• 최대 4361.9 Btu/hr, 230 cfm
규정(다음과 같은 요건을 충족)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>안전:</b> UL/CSA 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 CB Scheme(각 국가마다 편차 있음), IEC 825-1, 2 CFR 21 part 1040, CNS 14336</li> <li>• <b>EMI/EMC:</b> EN 55022 Class A, 47 CFR 15B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, AS/NZ 3548 Class A, CNS 13438 Class A, KSC 5858 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3</li> <li>• <b>내성:</b> EN 55024, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11</li> <li>• <b>규정:</b> CE, FCC, ICES-003, C-Tick, VCCI, GOST-R, BSMI, MIC, UL/cUL, UL/S-Mark</li> </ul>	
크기 및 출하 중량	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>높이:</b> 129.85mm (5.11인치), 3RU</li> <li>• <b>너비:</b> 436.5mm(17.185인치)</li> <li>• <b>깊이:</b> 732mm(28.81인치)</li> <li>• <b>무게:</b> 최대 36.28kg(80lbs.) - 랙 마운트형 키트 제외</li> </ul>	

## 보증

본 제품에 대한 오라클의 전 세계적인 보증 지원 정보는 [oracle.com/sun/warranty](http://oracle.com/sun/warranty)에서 확인할 수 있습니다.

## 서비스

본 제품에 대한 오라클의 서비스 프로그램은 [oracle.com/sun/services](http://oracle.com/sun/services)에서 확인할 수 있습니다.

## 문의처

오라클의 SPARC T3-2에 대한 보다 자세한 정보는 [www.oracle.com/kr](http://www.oracle.com/kr)에서 확인하거나 080-2194-114로 전화하여 한국오라클 담당자에게 문의하십시오.



Oracle is committed to developing practices and products that help protect the environment

Copyright © 2010, Oracle 및/또는 그 계열사. All rights reserved.

본 문서는 정보의 목적으로만 사용되며 일체의 내용은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 본 문서는 오류에 대해 책임지지 않으며 특정 목적에 대한 적격성 및 적합성과 관련된 명시적 보증 및 계약 조건을 포함해서 명시적, 묵시적 기타 모든 보증 또는 계약 조건에 의해 구속 받지 않습니다. 오라클은 본 문서와 관련해 어떠한 법적 책임도 지지 않으며, 본 문서로 인해 직간접적인 어떠한 계약 구속력도 발생하지 않습니다. 본 문서는 Oracle의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(전자적 또는 기계적) 또는 목적으로도 복제되거나 배포할 수 없습니다.

Oracle 및 Java는 오라클 및/또는 그 계열사의 등록 상표입니다. 기타 명칭은 해당 소유업체의 상표입니다.

AMD, Opteron, AMD 로고 및 AMD Opteron 로고는 Advanced Micro Devices의 상표 또는 등록 상표입니다. Intel 및 Intel Xeon은 Intel Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다. 모든 SPARC 상표는 라이선스 하에서 사용되며, SPARC International, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. UNIX는 X/Open Company, Ltd.를 통해 라이선스되는 등록 상표입니다. 0410

**Hardware and Software**  
**Engineered to Work Together**